

公司代码：688049

公司简称：炬芯科技

炬芯科技股份有限公司
2023 年年度报告摘要



第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2023年度使用超募资金通过集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为1,588,854.67元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

经过公司董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），且每10股以资本公积转增2股。截至2024年2月29日，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为120,682,022股，以此计算合计拟派发现金红利24,136,404.40元人民币（含税），转增24,136,404股。本次转增后，公司的总股本为146,136,404股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准）。

如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	炬芯科技	688049	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	XIE MEI QIN	肖洁雯
办公地址	珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区	珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区
电话	0756-3673718	0756-3673718
电子信箱	investor.relations@actionstech.com	investor.relations@actionstech.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务情况

公司是中国领先的低功耗 AIoT 芯片设计厂商，主营业务为中高端智能音频 SoC 芯片的研发、设计及销售，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网(AIoT)领域提供专业集成芯片。

2.主要产品情况

公司的主要产品为蓝牙音频 SoC 芯片系列、端侧 AI 处理器芯片系列、便携式音视频 SoC 芯片系列等，广泛应用于蓝牙音箱、无线家庭影院音响系统、智能手表、无线麦克风、无线收发 dongle、蓝牙耳机、无线电竞耳机、蓝牙语音遥控器及低功耗端侧 AI 处理器等领域。

公司的 SoC 芯片系列产品作为系统级芯片，将多个模块或组件、算法及软件等集成到一颗芯片中，对于基于先进半导体工艺的芯片研发设计及软硬件协同开发技术的要求较高。公司的 SoC 芯片包含完整的硬件电路及其承载的相关嵌入式软件和算法，在进行芯片设计的同时提供了相应的应用方案；将复杂的硬件电路和软件系统有效结合以实现芯片产品的功能，应用领域广泛。此外，顺应人工智能的发展大势，从高端音频芯片入手，公司将在产品整合低功耗 AI 加速引擎，逐步升级为 CPU、DSP 加 NPU 的三核异构 AI 计算架构，以打造低功耗端侧 AI 算力。




公司的核心产品：

(1) 蓝牙音频 SoC 芯片系列：公司的蓝牙音频 SoC 芯片主要应用于蓝牙音箱（含 TWS 音箱、智能蓝牙音箱）、智能蓝牙穿戴设备（含智能手表、AR 眼镜、OWS 耳机、TWS 耳机等）、无线家庭影院音响系统、无线麦克风、无线电竞耳机、无线收发 dongle 等。

应用示例	主要产品系列	主要应用领域	部分终端品牌
	ATS281X 系列、ATS282X 系列、ATS283X 系列(除 ATS2837)、ATS285X 系列、ATS283XP 系列、ATS303X 系列	普通蓝牙音箱(含 TWS 音箱)、智能蓝牙音箱、蓝牙车载产品、K 歌麦克风、无线收发 dongle、无线家庭影院音响系统、无线麦克风	哈曼、SONY、OPPO、罗技、安克创新、沃尔玛、小米、荣耀、漫步者、华为、绿联、Vizio、LG、Razer、Samsung、海信、TCL、Polk、大疆、RODE、猛玛、枫笛等
	ATS308X 系列、ATS301X 系列、ATS302X 系列、ATS303X 系列	智能手环/手表、无线电竞耳机、OWS 耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、TWS 耳机、AR 眼镜	小米、荣耀、Noise、Fire-Boltt、Titan、realme、Nothing、boAt、西伯利亚、倍思、传音、JBL、TOZO、INMO 等

注：公司已进入上述终端品牌的供应链，上述终端品牌在报告期内非公司的直接销售客户。

(2) 端侧 AI 处理器芯片系列：近年来，电子产品正朝着智能化、轻量化和便携化方向快速发展，随着以深度学习神经网络为代表的人工智能算法的快速发展与新一代人工智能技术及应用迭代更新，电子产品的潜在下游应用出现更多更广泛的场景通道。人工智能技术必然会赋能终端设备日新月异的智能化升级。公司的端侧 AI 处理器芯片是基于端侧的带有人工智能加速器的系统级音频处理器，致力于提供智能物联网 AIoT 端侧低功耗算力的芯片平台，也是公司主营的音频产品和人工智能技术的重要结合点，可满足市场未来日新月异的低功耗端侧设备的人工智能应用需求。公司将持续加大研发投入，在产品中逐步整合 AI 加速引擎，以打造低功耗端侧 AI 算力，致力于提供高能耗比、高集成度、高性能和高安全性的端侧 AIoT 芯片产品。

应用示例	主要产品系列	主要应用领域	部分终端品牌
	ATS360X 系列	智能办公类产品(如会议音箱)、智能家居和家电话音交互模组	eMeet、音络、向往、飞利浦等
	ATS2837	智能录音笔	飞利浦、汉王等
	ATB110X 系列、ATB111X 系列	蓝牙语音遥控器、语音鼠标、语音键盘、翻译棒及其它数据传输类产品	罗技、小米、FetchTV、创维、长虹、Caixun、Vestel、当贝、极米、峰米等

注：公司已进入上述终端品牌的供应链，上述终端品牌在报告期内非公司的直接销售客户。

(3) 便携式音视频 SoC 芯片系列：便携式音视频 SoC 芯片系列搭载了公司长期积累的、较先进的低功耗音视频处理技术，主要针对便携式高品质音视频编解码类产品的应用。

应用示例	主要产品系列	主要应用领域	部分终端品牌
	ATJ212X 系列、 ATJ215X 系列、 ATJ229X 系列、 V100	高品质音乐播放器、录音笔、高品质视频播放器、广告机、数码相框、视频故事机	纽曼、飞利浦、锐族、联想、先科、创维等

注：公司已进入上述终端品牌的供应链，上述终端品牌在报告期内非公司的直接销售客户。

(二) 主要经营模式

作为集成电路设计企业，公司采用行业常用的 Fabless 经营模式，即专门从事集成电路的研发设计，晶圆制造和测试、芯片封装和测试均委托专业的集成电路制造企业、封装测试企业完成，取得芯片成品后对外销售。同时，为了缩短芯片产品的面市时间，降低客户的开发门槛，公司在提供 SoC 芯片的同时，提供完善的 SoC 软件开发平台（算法库、OS、SDK、应用软件和开发工具等），针对不同品类的特性以及市场需求，为客户提供融合硬件和算法的整体解决方案。

1、研发模式

公司研发流程如下：

在立项阶段，市场部根据市场调研情况提出市场需求，各研发部门根据市场需求文档提出各自领域的研发需求以及技术创新需求，由项目经理组织各部门进行需求的可行性评估和立项评审。当项目评审通过后，项目正式立项。

在研发阶段，各研发部门共同讨论并制定芯片的设计规格书，IC 研发部将根据设计规格书进行电路设计、仿真和验证、物理实现以及封装设计工作，完成所有工作后，召开 Tape out 评审会议；同时，系统研发部和算法研发部进行芯片应用方案的开发工作。在新产品 Tape out 评审会通过，制造工程部委托晶圆制造厂、封装测试厂依照与量产流程相似的标准进行样品试生产，同时进行晶圆和封装测试环境的开发。样品完成后，各研发部门会进行芯片验证和样机测试，核实样品是否达到各项设计指标。

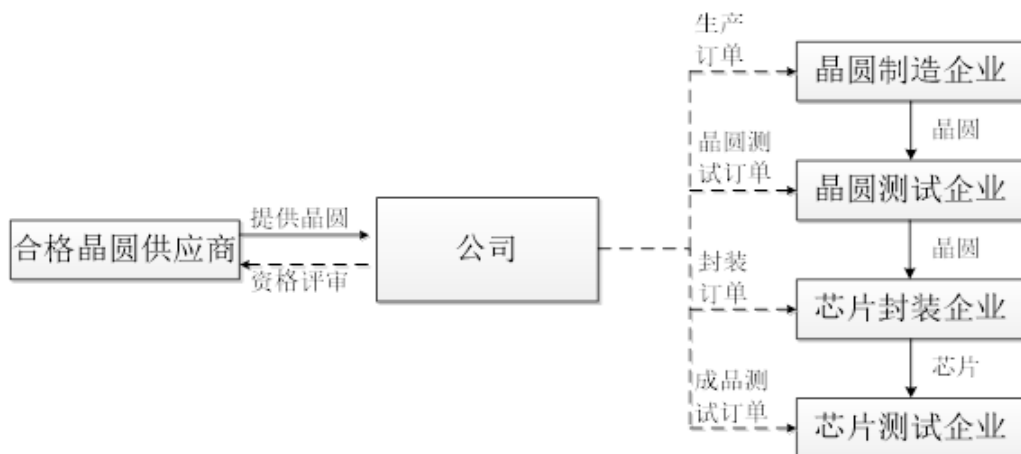
在新产品验证通过后，系统研发部将发布应用方案级别的软件和硬件开发平台，开始进行客户端产品试量产。在试量产成功完成后，进入芯片量产阶段。

2、采购与生产模式

公司采用 Fabless 模式，主要负责集成电路的设计，因此需要向晶圆制造厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。

运营管理部依据市场部/业务部的出货预测制定相应采购计划和生产计划，并由晶圆制造厂和封装测试厂完成晶圆制造、晶圆测试、芯片封装测试等委外生产工作。此外，公司还会采购存储等配套芯片。

采购生产流程：



3、销售模式

根据集成电路行业惯例和自身特点，公司采用“经销为主，直销为辅”的销售模式，均为买断式销售。公司在销售过程中，除了提供 SoC 芯片，还可为客户提供融合软硬件和算法的整体解决方案。

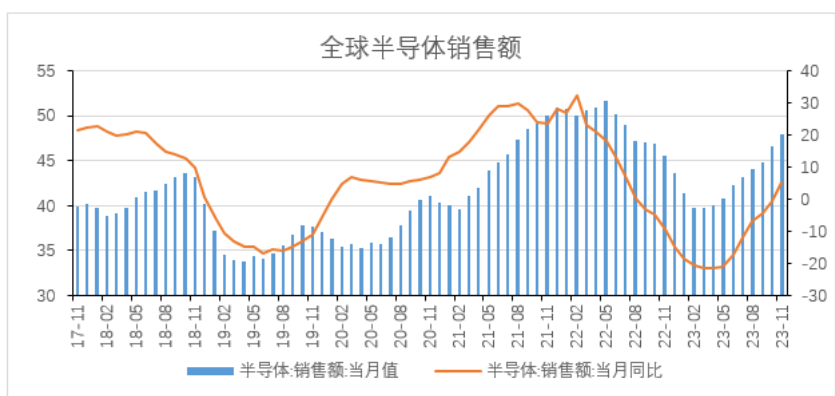
(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业的发展阶段及基本特点

公司主营业务是中高端智能音频 SoC 芯片的研发、设计及销售，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网(AIoT)领域提供专业集成芯片。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

根据《国家集成电路产业发展推进纲要》，集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期，行业处于快速发展阶段，正全力追赶世界先进水平。近年来，随着物联网、人工智能、新能源汽车、智能穿戴等应用领域的不断发展，全球电子产品市场规模逐年扩大。据美国半导体产业协会数据，2023年12月全球半导体销售额为487亿美元，同比增长11.6%，环比增长1.4%，连续10个月实现环比正增长；中国半导体销售额约151亿美元，同比增长19.4%，环比增长4.7%，连续10个月实现环比正增长。展望2024年，在AI、MR、数据中心等多重驱动下，电子行业将有望持续走在复苏的道路上。



① 蓝牙的技术革新带动蓝牙音频 SoC 芯片需求增长

近年来随着物联网行业蓬勃发展，蓝牙作为物联网无线连接的主要方式之一，终端设备应用场景诸多，出货量自 1998 年蓝牙技术推出以来即呈现持续增长的趋势。SIG 发布的《2023 年蓝牙市场最新资讯报告》指出，虽然近期的预测比去年略有下降，但预计在未来五年的后半段蓝牙市场会有更高的增长；至 2027 年，蓝牙设备年出货量将达 76 亿台，2023 年到 2027 年的年复合增长率为 9%。其中，音频传输是蓝牙技术最早和最重要的应用领域，从蓝牙技术推出以来便呈现技术不断革新与终端应用持续增长的态势。由于音频传输是蓝牙物联网设备及可穿戴技术最为成熟、应用场景最为完备的领域，蓝牙音频设备在近些年也成为智慧互联的首要流量入口。根据 SIG 的统计及预测，2022 年全球蓝牙音频产品的出货量约 13.6 亿台，到 2027 年仅蓝牙音频传输设备年出货量将达 18.4 亿台，2023 年到 2027 年的年复合增长率为 6%。尽管受宏观经济、国际形势和全球通胀等影响，蓝牙音频仍持续出现线性增长。其中，蓝牙音箱 2023 年出货量预计将达 3.6 亿台，蓝牙智能手表 2023 年出货量预计为 1.43 亿只。

②端侧 AI 处理器芯片具有广阔的市场前景

随着 AI 大模型加速涌向设备端，从手机、笔记本电脑，到 AR/VR、汽车和整个物联网终端生态都将随之改变。端侧算力将是 AI 大模型应用落地在硬件设备中不可或缺的一部分。除了由于云端算力不可能承载持续无限增长的庞大计算需求的因素之外，可定制化、低成本、低时延、高安全性及隐私性等需求涌现，由此需要让更多算力需求传导到终端，依靠端侧算力来解决这些需求。同时，兼顾更高的算力与低功耗将成为端侧 AI 处理器芯片追求的目标。以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 模型提升了对用户意图的理解，对用户的反馈更加准确丰富，如对用户的个性化服务、快速收集与处理信息、提升场景交互效率等，伴随人工智能交互技术与智能硬件产品结合的趋势，有望大幅提升人机交互体验，生成式 AI 将赋予智能设备更强的产品竞争力，为各行业数字化和智能化渗透带来显著提升。其中，AI 模型在音频领域有许多应用场景，包括语音识别、噪音抑制、语音翻译、语音/音频关键词识别、人声增强、人声分离等，具有广阔的市场前景。云端 AI 计算和端侧 AI 计算有机结合才构成人工智能的完整的生态，另外低功耗装置对于端侧人工智能算力提出新的挑战和需求，低功耗端侧计算技术和产品上的落地将带来新一代技术创新和产品迭代，未来将表现出快速成长和无限生机。

③便携式音视频 SoC 芯片行业呈现“长尾效应”，市场已向公司为代表的头部企业集中

便携式音频 SoC 芯片主要应用于便携式音频播放器和便携式录音笔等，便携式视频产品广泛用于唱戏机和广告机等领域，已进入“长尾状态”。便携式音视频产品在公司整体产品体系布局中，承担着稳定业绩贡献的作用，并对技术发展提供基础。

(2) 主要技术门槛

集成电路设计的流程首先要进行软硬件划分，将设计基本分为两部分：芯片硬件设计和软件协同设计。高质量的芯片不仅需要在体积、容量、安全性方面满足市场要求，还需保证能耗、稳定性、抗干扰能力等诸多需求，因而集成电路设计公司既需要掌握各种元器件的应用特性，又需要以技术积累和行业经验为基础熟悉配套的软件技术。此外，芯片产品的研发设计需要紧密跟上国际先进技术水平，同时优化现有技术，持续进行改进和创新，提高产品应用设计能力，才能在行业众多竞争者中占据优势。公司的 SoC 芯片包含完整的硬件电路及其承载的相关嵌入式软件和算法，产品高度的系统复杂性和专业性决定了进入公司所在行业具有很高的技术壁垒，行业内的后来者短期内很难突破核心技术壁垒，只有经过长时间技术探索和不断积累才能与拥有技术优势的企业相竞争。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是较早从事 SoC 芯片研发、设计和销售的高新技术企业，经过多年在智能音频芯片领域的研发投入、技术积累和发展，公司拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，核心技术权属清晰，技术水平较先进，成熟并广泛应用于公司产品的批量生产中。公司的核心技术涵盖了高性能

音频 ADC/DAC 技术、高性能低延迟的无线通信技术、高集成度的低功耗技术、高音质体验的音频算法处理技术、高度自主 IP 技术和高集成度 SoC 设计整合框架、高性能软硬件融合的系统平台技术等。公司产品在专业音频厂商中占有率较高，并已进入多家知名的手机品牌和互联网厂商的音箱、手表、耳机等不同形态的智能终端产品供应链中。从覆盖品牌的广度和深度上看，公司具有明显优势。

（1）蓝牙音频 SoC 芯片系列

①蓝牙音箱 SoC 芯片系列

公司是全球蓝牙音箱 SoC 芯片的重要供应商之一。得益于公司产品竞争力的不断提升，蓝牙音箱芯片已是公司目前的主力产品和重要收入来源。在蓝牙音箱领域，公司已成为行业终端品牌的主流供应商，尤其是中高端蓝牙音箱 SoC 在国际一线品牌已实现突破。公司主要服务于国内外一二线终端品牌，包括哈曼、SONY、安克创新、荣耀、小米、罗技等众多终端品牌，通过提供差异化搭配的系列芯片组合，可满足市场上终端品牌的差异化需求，得到了业界主流终端品牌和 ODM/OEM 代工厂的普遍认可，持续加大主流终端品牌的渗透率。

其中，低延迟高音质无线音频 SoC 芯片是公司积极耕耘的细分市场，目前主要覆盖无线家庭影院音响系统、无线麦克风、无线电竞耳机、无线收发 dongle 等细分市场，并已进入 SONY、Vizio、海信、TCL、Polk、大疆、RODE、猛玛、枫笛、西伯利亚、倍思等多个品牌。在无线家庭影院音响系统、无线麦克风和无线电竞耳机市场，终端产品无线化趋势以及全景声影视驱动的增量需求将带来细分市场的稳健增长。

②智能蓝牙穿戴 SoC 芯片系列

公司智能蓝牙穿戴 SoC 芯片包括智能手表 SoC 芯片、蓝牙耳机 SoC 芯片等。

其中，智能手表 SoC 芯片是公司重点业务拓展新方向。根据市场调查机构 Canalys 公布的全球可穿戴腕带设备（含基础手环/手表、智能手表）分析预测数据显示，2023 年该品类的总销量为 1.86 亿台，增长 2%。而其增长的主要动力是新兴市场。展望未来，可穿戴腕带设备即将迈入更加持续的增长阶段。Canalys 预测 2024 年可穿戴腕带设备的增长率将达到 10%。公司凭借多年来在低功耗技术、显示技术、蓝牙双模技术以及音频技术的积累，2021 年底开始向市场推出第一代高集成度的智能手表 SoC 芯片 AT33085L/85C/85，单芯片解决方案一经推出即得到终端品牌认可，并且已经应用在小米、荣耀、Noise、Fire-Boltt、Titan、realme、Nothing、boAt 等多款终端手表和手环产品中。截止目前，公司新一代智能手表芯片 AT33085E/S 以及 AT33089X 系列已经正式发布，且已经有终端手表产品量产上市。

公司蓝牙耳机 SoC 芯片已进入荣耀、realme、传音、JBL、倍思、TOZO 等终端耳机品牌供应链。同时，公司在积极耕耘耳机细分市场，如开放式耳机、头戴耳机等，并已进入倍思、TOZO 等品牌，未来将持续为广大用户带来沉浸式音频体验。

（2）端侧 AI 处理器芯片系列

随着 ChatGPT 等生成式 AI 的兴起，在低功耗端侧设备进行边缘 AI 计算的需求也将显著增加。公司将从智能音频入局，率先发力。公司的端侧 AI 处理器芯片首先落地于音频产品的应用，将基于多核异构 AI 计算架构，打造低功耗端侧 AI 算力，以满足日益增长的终端设备智能化需求。当前芯片首先落地在智能办公和智能家居等语音交互领域，其中包括蓝牙语音遥控器、语音鼠标、翻译棒以及智能录音笔等产品中。公司将密切关注生成式 AI 行业发展趋势，与客户密切合作，大力推动 AI 技术在端侧设备上的落地，切实提升低功耗端侧 AIoT 设备的用户体验。

（3）便携式音视频 SoC 芯片系列

公司的便携式音视频 SoC 芯片系列产品的全球市场占有率较高，主要围绕音视频编解码应用落地。公司在音质和功耗等方面持续精进和不懈努力，在该领域积累了大量较为稳定的客户。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 蓝牙音频 SoC 芯片行业技术水平及发展趋势

①蓝牙技术实现功耗、成本、功能的较好结合，在应用开发等方面拥有优势

在目前主要的几种无线通信技术中，由于蓝牙技术可实现功耗、成本、功能等方面的兼顾统一，应用开发扩展性强，在效率和安全性上均具有较大的优势。

②低功耗音频（LE Audio）技术再次改变人们体验音频方式

2022年7月，蓝牙技术联盟 SIG 正式宣布，LE Audio 技术的全套规格已制定完成。LE Audio 具备低功耗、高音质、支持多连接和音频分享等优势，相较于经典蓝牙，新一代蓝牙音频技术标准——LE Audio 有效地改变了蓝牙音频产品在延迟、音质、功耗以及连接稳定性上的表现，还可为助听器等新的应用提供更强大的支持。这一新的蓝牙技术将再次改变人们体验音频的方式，并让人们以前所未有的方式进行万物互联。

③双模蓝牙产业会全面升级支持 LE Audio 新标准，并以双模蓝牙音频形式成为市场和技术的

主流。
双模蓝牙（即经典蓝牙+低功耗蓝牙）产业将全面升级支持 LE Audio 新标准，实现同时支持经典蓝牙以传统模式传输音频和低功耗蓝牙以 LE Audio 模式传输音频的双模蓝牙音频功能。支持双模蓝牙音频的设备既能兼容现有不支持 LE Audio 标准的蓝牙设备，又能兼容未来的仅支持 LE Audio 标准的蓝牙设备。

在蓝牙技术联盟正式宣布低功耗音频（LE Audio）全套规格制定完成前，公司就已经开始着手在 LE Audio 技术上投入研发和探索。目前，公司的蓝牙音频芯片已经在全面升级支持 LE Audio 新标准，部分指标已经处于行业领先地位，并支持双模蓝牙音频，支持 LE Audio 的产品方案已经发布。

④2.4G 无线私有协议与蓝牙单芯片方案持续渗透细分市场

在电竞游戏、视频直播以及无线家庭影院等对于音视频同步十分敏感以及有线转无线需求推动的细分市场，2.4G 无线私有协议相较于蓝牙方案具备效率更高、抗干扰能力更强、延迟低、高带宽、高音质等特点，但在场景兼容性上需要蓝牙进行补充，市场往往会采用双芯片甚至三芯片作为解决方案。随着终端品牌客户对于产品高集成度和低功耗要求的不断提升，2.4G/BT 双模单芯片方案逐步成为业内共同选择。公司较早布局 2.4G/BT 双模单芯片方案，无线收发一体芯片产品具有领先的综合性能表现，可广泛应用于无线家庭影院音响系统、无线麦克风、无线电竞耳机、无线收发 dongle 等低延迟产品。

(2) 端侧 AI 处理器芯片行业技术水平及发展趋势

AIGC 时代下，云端作为 AI 大脑处理主要的训练和部分推理任务，边缘端和终端作为 AI 的小脑与四肢处理即时、频繁的用户端推理任务，并具备成本、隐私性双重优势。在端侧 AI 升级方面，一类是以手机、PC、汽车、机器人等为代表的算力较强的产品，另一类则是 IoT 产品的 AI 能力升级。

AIoT 产品，受制于功耗、散热、产品形态等方面的限制，算力的升级将更多关注单位 mW 下算力的数量级提升，实现路径上须从计算架构和芯片电路进行创新，才能带来更好的 AI 体验。此外，AIoT 产品在承担轻量级的 AI 处理功能之外，在音频应用领域也承担了如语音交互、人声隔离等数据入口的抓手功能，因此对于连接的低功耗、低延迟、抗干扰传输互联、高能效比皆具有更高的要求，为未来端侧 AI 落地应用奠定基础。

(3) 便携式音视频 SoC 芯片行业技术水平及未来发展趋势

便携式音视频 SoC 芯片在低功耗的基础上，提供高品质的数字多媒体信号编解码和处理，保证数模转换和模拟后处理的全信号链的高信噪比。未来便携式音视频 SoC 芯片将继续向低功耗、高音质和更强交互体验等方向演进。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	1,926,597,146.57	1,850,767,362.54	4.10	1,819,259,753.85
归属于上市公司股东的净资产	1,809,707,717.05	1,769,218,862.53	2.29	1,712,037,241.73
营业收入	520,099,364.94	414,703,877.23	25.41	526,267,171.76
归属于上市公司股东的净利润	65,058,595.89	53,751,796.62	21.04	83,947,793.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,126,424.21	31,145,025.16	64.16	59,955,733.19
经营活动产生的现金流量净额	155,093,306.01	-134,310,380.89	不适用	86,190,899.91
加权平均净资产收益率(%)	3.64	3.09	增加0.55个百分点	14.81
基本每股收益(元/股)	0.53	0.44	20.45	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.44	20.45	0.89
研发投入占营业收入的比例(%)			增加1.73个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	8,142.92	13,787.29	15,690.02	14,389.70
归属于上市公司股东的净利润	800.88	1,669.42	2,222.33	1,813.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52.38	1,548.35	2,058.91	1,453.01
经营活动产生的现金流量净额	3,053.32	3,584.58	3,836.69	5,034.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,008
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,076

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）						不适用		
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）						不适用		
前十名股东持股情况								
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量	质押、标记 或冻结情 况		股 东 性 质
						股份 状态	数 量	
珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）	0	28,223,600	23.13	28,223,600		无	0	其他
厦门炬佳微投资合伙企业（有限合伙）	-1,552,203	2,991,197	2.45	0		无	0	其他
珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）	0	2,891,000	2.37	2,891,000		无	0	其他
厦门炬上益投资合伙企业（有限合伙）	-1,228,496	2,793,434	2.29	0		无	0	其他
厦门炬上吉投资合伙企业（有限合伙）	-1,353,393	2,701,087	2.21	0		无	0	其他
厦门炬上仁投资合伙企业（有限合伙）	-1,678,255	2,439,925	2.00	0		无	0	其他
重庆景昱企业管理合伙企业（有限合伙）	-1,218,495	2,347,505	1.92	0		无	0	其他
重庆铭协企业管理合伙企业（有限合伙）	-1,219,922	2,318,078	1.90	0		无	0	其他
中国银行股份有限公司—泰信中小盘精选股票型证券投资基金	2,100,000	2,100,000	1.72	0		无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	2,071,697	2,071,697	1.70	0		无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与股东珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人同为宏迅创建有限公司，委派代表同为叶奕廷。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用				

存托凭证持有人情况

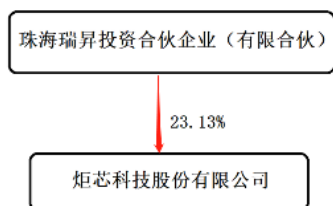
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

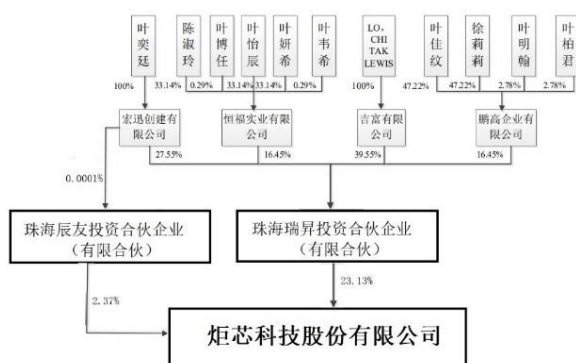
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关内容

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用